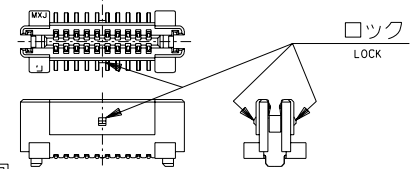


DWG. NO.
SD-52584-007

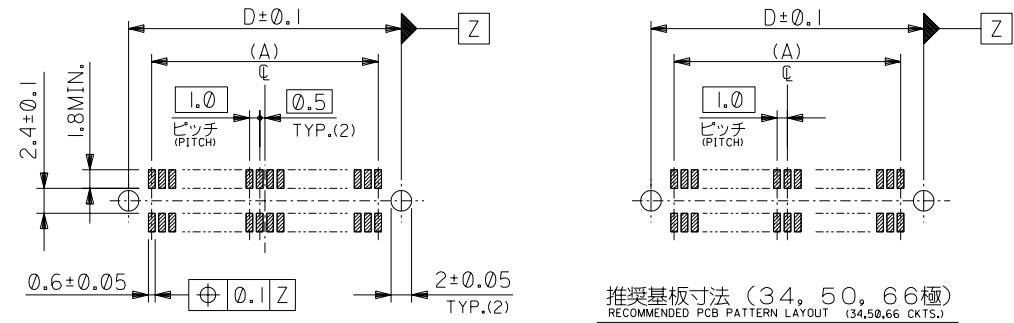
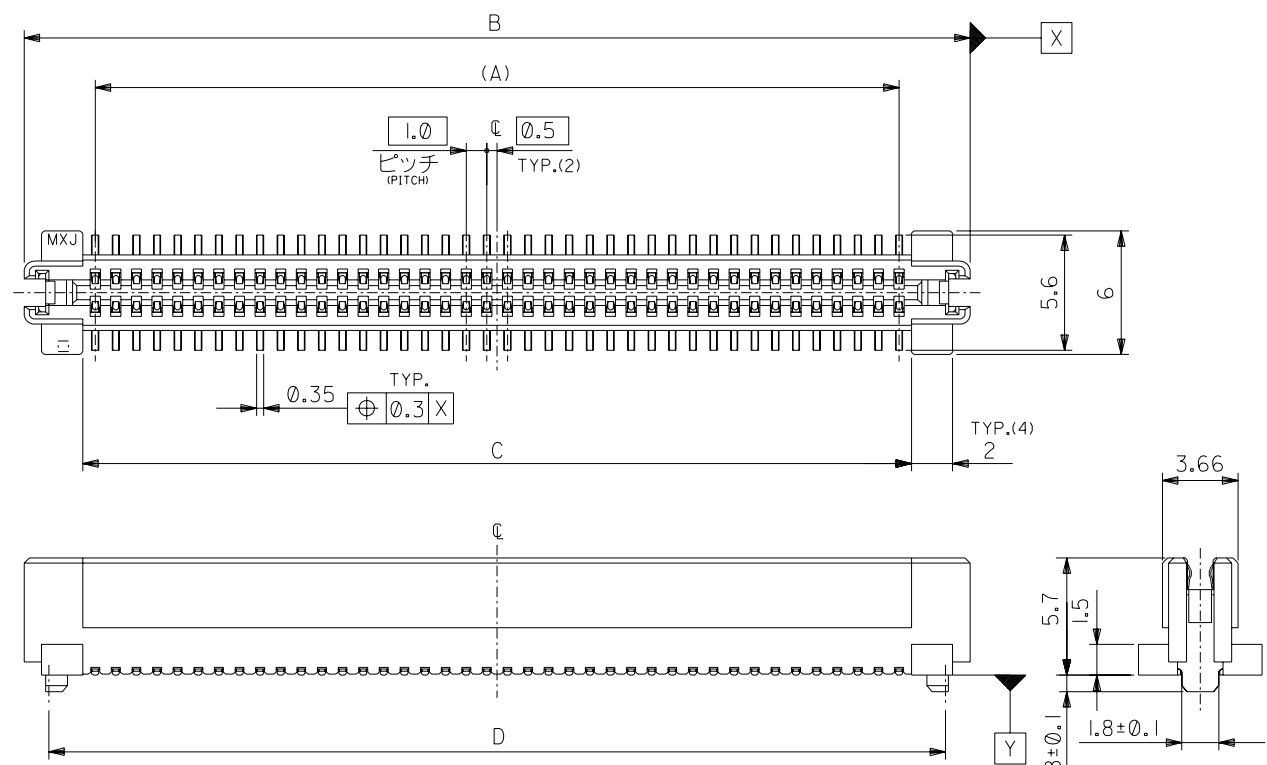
MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

注)
NOTES

- 材質
MATERIAL
ハウジング: ガラス入りLCP、白色、UL94V-0
HOUSING: F.LCP, WHITE, UL94V-0
ターミナル: 燐青銅 (t=0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様
PLATING
接点部: 金メッキ 0.25 マイクロメートル以上。
CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM.
半田付け部: 錫メッキ 1.0 マイクロメートル以上。
SOLDER TAIL AREA: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ: ニッケルメッキ 2.0 マイクロメートル以上。
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 MICROMETER MINIMUM.
- 推奨基板厚
RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.0±0.1mm MIN.
- テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テールは、Y面を基準とし、上へ0.02 下へ0.15 の範囲にあり、目つテール平坦度は0.15とする。
TAILS TO BE WITHIN 0.02 UPWARD AND 0.15 DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE, AND TAIL COPLANARITY TO BE 0.15.
- ロックは、20、34、50極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO 20, 34 AND 50 CKTS.
- 梱包
PACKAGING
本製品はスティック梱包とし梱包後の MATERIAL NO. は52584-***79とする。
THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE. MATERIAL NO.: 52584-***79
- 同一基板内に複数個(2ヶ以上)の使用は避けてください。
MXJ DOSE NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.BOARD.
- 本製品は52584-***0の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52584-***0.



73.5	70.2	75.9	69	52584-1408	140
63.5	60.2	65.9	59	52584-1208	120
53.5	50.2	55.9	49	52584-1008	100
45.5	42.2	47.9	41	52584-0848	84
43.5	40.2	45.9	39	52584-0808	80
36.5	33.2	38.9	32	52584-0668	66
33.5	30.2	35.9	29	52584-0608	60
28.5	25.2	30.9	24	52584-0508	50
20.5	17.2	22.9	16	52584-0348	34
13.5	10.2	15.9	9	52584-0208	20
D	C	B	(A)	MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKTS.



推奨基板寸法 (20, 60, 80, 84, 100, 120, 140極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (20,60,80,84,100,120,140 CKTS.)

推奨基板寸法 (34, 50, 66極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (34,50,66 CKTS.)

角度 ANGLE	±3°				
30°以上 OVER	+0.3				
10°以上 OVER 30°未満 UNDER	+0.25				
未満 10° UNDER	+0.2				
一般公差 GENERAL TOLERANCES	①	新規作成 RELEASED (J2004-3257)	DR. K.T	04/03/22	
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—
被覆外径 INS. RANGE	—#—
DRAWN BY 04/03/22 H.KAWABATA	CHK'D BY 04/03/22 K.TOJO
APP'D BY 04/03/22 M.SASAO	尺度 SCALE —#—

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 1.0 B-T0-B S/T REC.HS'G ASS'Y -LEAD FREE-	
DWG. NO. SD-52584-007	REV 0

7

6

5

4

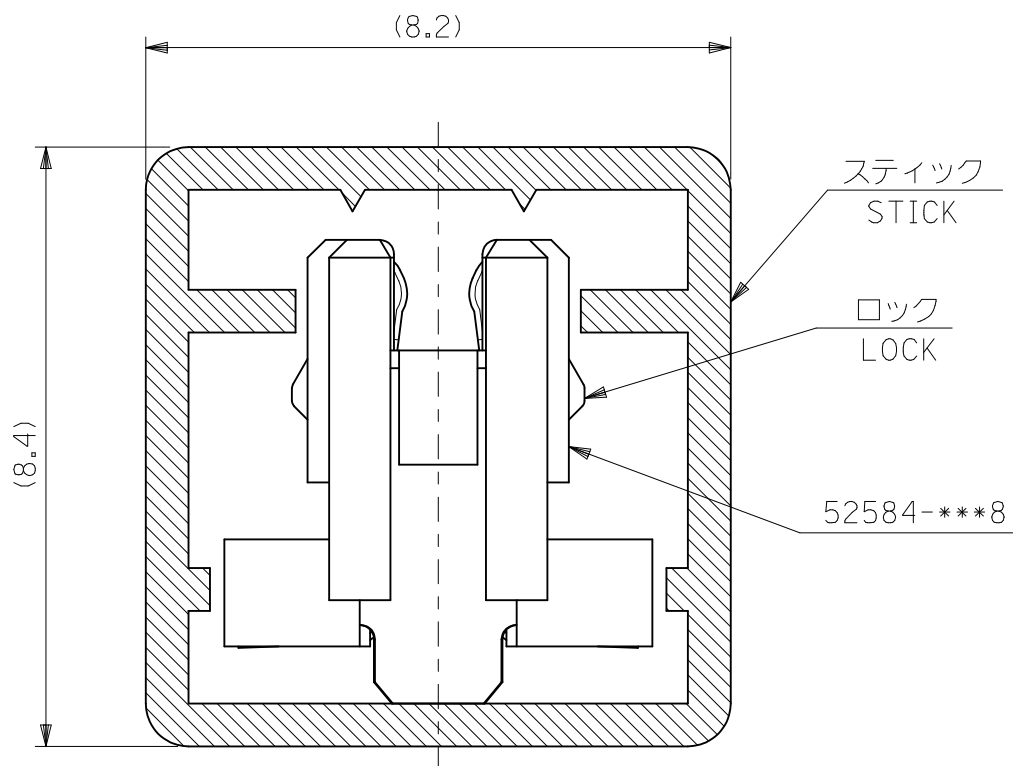
3

2

1

注記
NOTES

- スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
- 全 長: 600 ± 2
TOTAL LENGTH
- 肉 厚: 0.6 ± 0.2
THICKNESS
- ロックは、20, 34, 50極に設置。
LOCK TO BE ADDED TO 20, 34
AND 50 CKTS.
- 本製品は52584-***9の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52584-***9.



7	52584-1479	140	
8	52584-1279	120	
10	52584-1079	100	
12	52584-0879	80	
15	52584-0679	60	
52584-***79	18	52584-0579	50
MODEL No.	梱包数 QUANTITY	MATERIAL No.	極数 NO. OF CKTS.

MATERIAL

スティック: ポリ塩化ビニル
STICK: P.V.C

REVISED

EC NO: J2011-1534
DRWN: TKAKIMOTO 2011/05/18
CHKD: THARUYAMA 2011/05/18
APPR: HIRATA 2012/06/07

DESCRIPTION
QUALITY SYMBOLS
 = CRITICAL
 = MAJOR
 = ZERO DEFECT
 = S.P.C.

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

DIMENSIONS \pm ---ANGULAR ± 3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY DATE
HKAWABATA '04/03/22

CHECKED BY DATE
KTOJO '04/03/22

APPROVED BY DATE
MSASAO '04/03/22

MATERIAL NO.

SEE TABLE

SIZE
A4

SCALE

TITLE

DESIGN UNITS
METRIC

52584-***8
STICK PACKAGING
-LEAD FREE-

molex

DOCUMENT NO.

SD-52584-008

SHEET NO.

1 OF 1

6

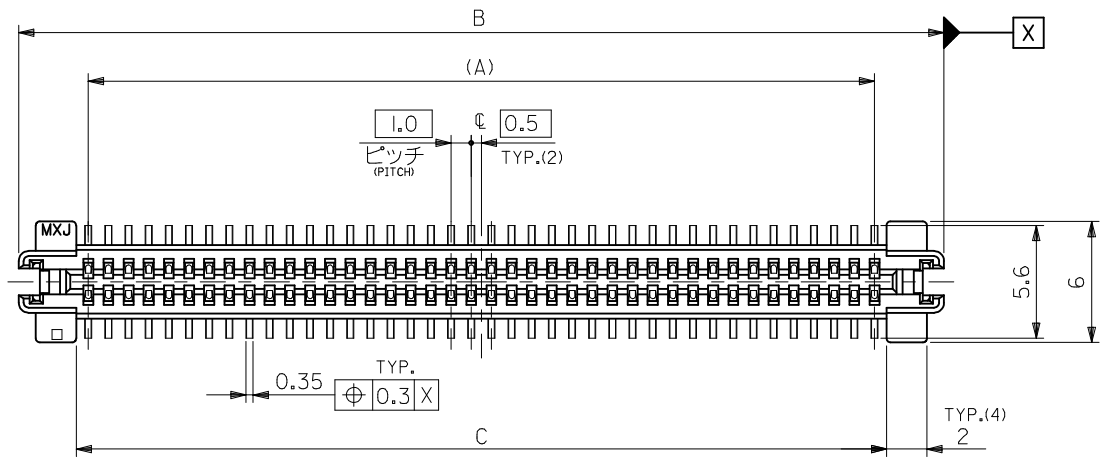
5

4

3

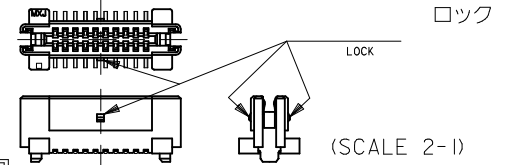
2

A

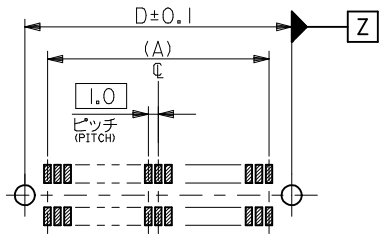
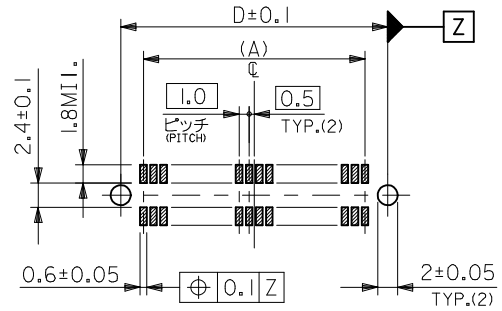
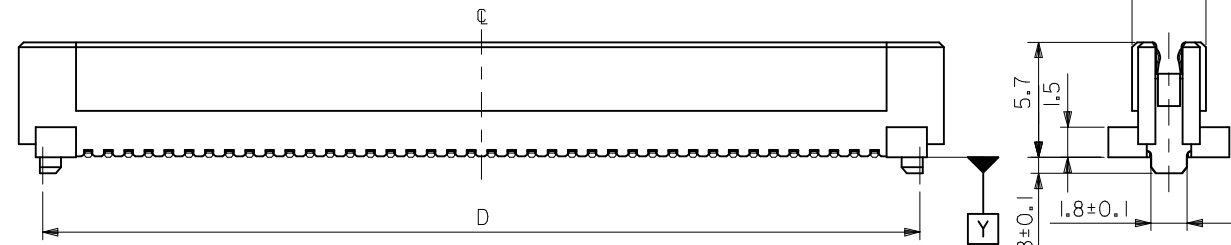


注) NOTES

1. 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入り LCP、白色、UL 94V-0
ターミナル: 燐青銅 (t = 0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
2. メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ 0.25 μm MIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.25 μm MIN.
半田付け部: 半田メッキ 1.0 μm MIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD 1.0 μm MIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 2.0 μm MIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 μm MIN.
3. 推奨基板厚 RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.0 ± 0.1 mm MIN.
4. テールのバラツキ許容 TAIL COPLANARITY
テールは、Y面を基準とし、上へ 0.02 下へ 0.15 の範囲にあり、目つテール平坦度は 0.15 とする。
TAILS TO BE WITHIN 0.02 UPWARD AND 0.15 DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE. AND TAIL COPLANARITY TO BE 0.15.
5. ロックは、20, 34, 50 極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO 20, 34 AND 50 CKTS.



6. 梱包 PACKAGING
本製品はスティック梱包とし梱包後の ENG. NO. は 52584-***9 とする。
THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE. ENG. NO.: 52584-***9
7. 同一基板内に複数個 (2ヶ以上) の使用は避けてください。
MXJ DOSE NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.B.OARD.



推奨基板寸法 (20, 60, 80, 84, 100, 120, 140 極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (20,60,80,84,100,120,140 CKTS.)
(SCALE 2-1)

推奨基板寸法 (34, 50, 66 極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (34,50,66 CKTS.)
(SCALE 2-1)

73.5	70.2	75.9	69	52584-1400	140
63.5	60.2	65.9	59	52584-1200	120
36.5	33.2	38.9	32	52584-0660	66
33.5	30.2	35.9	29	52584-0600	60
28.5	25.2	30.9	24	52584-0500	50
20.5	17.2	22.9	16	52584-0340	34
13.5	10.2	15.9	9	52584-0200	20
D	C	B	(A)	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.

REVISED EC NO: J	2008/11/06 DRWN: YOSHIDAM	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC		THIRD ANGLE PROJECTION	
	2009/03/23 CHKD: THARUYAMA		10 UNDER ±0.2	DRAWN BY J. MIYAZAWA	DATE	TITLE 1.0 B-T0-B S/T REC. HSG ASSY					
	2009/03/25 APPR: THARUYAMA		10 OVER 30 UNDER ±0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE	MOLEX INCORPORATED					
			30 OVER ±0.3	APPROVED BY H. IKESUGI	DATE	DOCUMENT NO. SD-52584-009					
			ANGULAR ±3 °	MATERIAL NO.		SHEET NO. 1 OF 1					
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							